## 公開特許公報フロントページ

(11)公開番号: 特開2001-254181

(43)公開日:

2001年09月18日

(51)Int.CI.7

C23C 16/46 16/34 16/44 H01L 21/285

301

21/31

(21)出願番号: 特願2001-000183

(71)出願人:

東京エレクトロン株式会社

(22)出願日:

2001年01月04日

(72)発明者:

松瀬 公裕

(30)優先権

優先権主張番号: 2000000590

優先日: 2000年01月06日

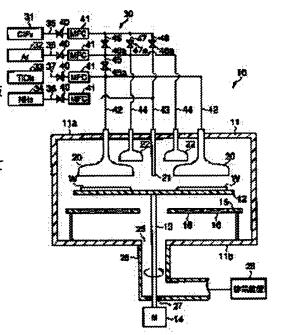
優先権主張国: JP

## (54) 成膜装置および成膜方法

### (57)【要約】

【課題】 高速スイッチングバルブを用いずにかつ高い 生産性で、ALD法を利用することができる成膜装置お よび成膜方法を提供すること。

【解決手段】基板Wを収容するチャンバー11と、チャンバー11内で複数の基板Wを平面的に支持する基板支持部材12と、チャンバー11内に設けられ、TiCl4を吐出する第1の処理ガス吐出ノズル20と、NH3を吐出する第2の処理ガス吐出ノズル21と、基板支持部材12を回転させる回転機構14と、基板Wを加熱するヒーター16とを具備し、基板支持部材12を回転させて基板Wを公転させながら、基板W上に、Tiの単原子層と、Nの単原子層とを交互に形成する。



### リーガルステータス

【審査請求日】

【拒絶査定発送日】

【最終処分種別】

【最終処分日】

【特許番号】

【登録日】

【拒絕查定不服審判番号】

【拒絶査定不服審判請求日】

【本権利消滅日】

# JAPANESE PATENT APPLICATION. FIRST PUBLICATION No. 2001-254181

INT. CL.7:

C23C

16/46, 16/34, 16/44

H01L 21/285, 21/31 PUBLICATION DATE: September 18, 2001

TITLE

Film Forming Apparatus and Film Forming Method

APPLICATION NO.

2001-000183

FILING DATE

January 4, 2001

APPLICANT(S)

**TOKYO ELECTRON KK** 

INVENTOR(S)

Kimihiro MATSUSE

PRIORITY NO.

2000-000590

PRIORITY DATE

January 6, 2000

**PRIORITY COUNTRY** 

JP (domestic priority)

#### **ABSTRACT**

PROBLEM -

To offer a film forming apparatus and film forming method capable of applying an ALD process with high productivity without using a high-speed switching valve.

SOLUTION - The invention comprises a chamber 11 for accommodating wafers W, a substrate supporting member 12 for planar support of a plurality of wafers W inside the chamber 11, a first processing gas expelling nozzle 20 for expelling TiCl4 and a second processing gas expelling nozzle 21 for expelling NH3 provided inside the chamber 11, a rotation mechanism 14 for rotating the substrate supporting member 12, and a heater 16 for heating the wafer W, wherein mono-atomic Ti layers and mono-atomic N layers are alternately formed on the substrates W while rotating the substrate supporting member 12 to make the substrates W revolve.

